



Deep Access Wedge-Wedge Bonder 5832

Bond System

Drahttypen	Alu- und Golddraht 17,5–75µm auf 2"-Spule Bändchen von 30x12,5µm bis 250x25µm
Bondkopf	Dünndraht Wedge-Wedge oder Bändchen Standard Tool von 1" Länge, (optional ¾") Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Ultraschall System	F&S US System 100kHz (optional 65, 120, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsbereich X/Y-Achse 200x150mm • Schrittauflösung 1 µm programmierbar • Programmierbare Z-Achse mit 100mm Hub
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet, • USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22" • GigE-CMOS-Farbkamera mit 5 MPixel • Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung
Software	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelbonds bis komplexe Programme, • Loopformen in Bibliotheken speicherbar • Optionale Bilderkennung
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Hochleistungseembedded ARM-System mit Echtzeitbetriebssystem für Präzisions-Bahnkurven • 1 Draht / Sekunde
Platziergenauigkeit	+/- 5µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat
Wiederholgenauigkeit	+/- 3 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat
Loophöhengenaugigkeit	+/- 5µm @ 3 sigma, bei Dünndraht 5830 mit 25µm Aluminium Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Die 58xx Serie:

Die Deep Access-Wedge-Wedge-Variante der automatischen Drahtbonder unserer Serie 58xx mit austauschbaren Bondköpfen.

Ideal geeignet für die Fertigung, da automatisch einsetzbar mit einer Bondgeschwindigkeit von typisch ein Draht pro Sekunde. Bauteilwechsel durch Bediener, der Bondablauf ist dank eingebauter Bilderkennung völlig bedienerfrei.

Einzelbonds sind in Sekunden herstellbar, daher auch perfekt für R&D, Pilotfertigung und Serienfertigung mit mittleren Losgrößen geeignet!

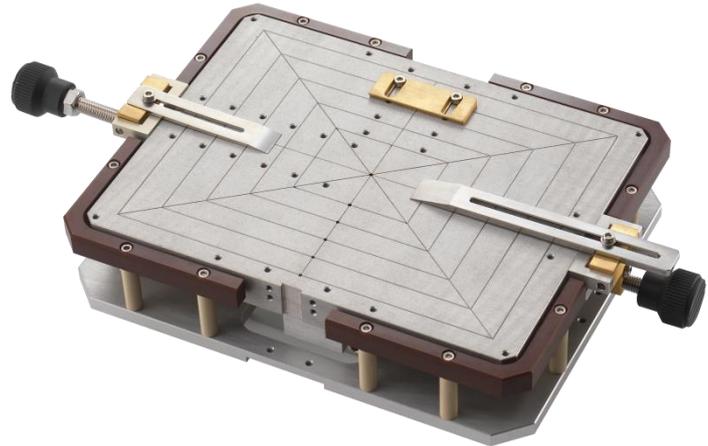
BONDING THE STARS



- Abmessung** B x T x H – 92 x 71 x 65 cm, Gewicht ca. 80kg
- Anschlüsse** 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA,
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
- Heizung** Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 8x6" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Vakuumaufnahme 6x6"
mit mechanischer Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at



Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

